

1. 適用範囲**1.1 内容**

本規格は MISコネクタ2.5mmピッチ(クリンプタイプⅢ)の製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。

適用製品名と型番はFig. 1の通りである。

2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、
本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の
間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用
すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が
生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 AMP 規格

- A. 109-5000 :試験法の一般条件
- B. 114-5260 :取付適用規格
- C. 501-5289 :試験報告書

2.2 民間団体規格

- A. MIL-STD-202 : 電子電気部品の試験方法
- B. IEC : 国際電気標準会議

1. Scope :**1.1 Contents**

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of Metric Interconnect System (MIS) Connector 2.5mm Pitch (Crimp TypeⅢ).

Applicable product description and part numbers are as shown in Fig. 1.

2. Applicable Documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 AMP Specifications :

- A. 109-5000 : Test Specification, General Requirements for Test Methods
- B. 114-5260 : Application Specification,
- C. 501-5289 : Test Report

2.2 Commercial Standards and specifications :

- A. MIL-STD-202 : Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts.
- B. IEC : International Electrotechnical Commission

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材 料

A. コンタクト :

錫めっき済 リン青銅

(錫めっき0.8 μ m以上)

B.ハウジング : 66ナイロン (UL94V-0)

C. ポストヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)

ポスト : はんだめっき済黄銅

(銅下地0.5 μ m以上の上に

はんだめっき0.8 μ m以上)

ハウジング : 66ナイロン (UL94V-0)

3.3 定 格

A. 定格電圧 250 VAC/DC

B. 定格電流 (最大)

AWG#22:3A, AWG#24:3A, AWG#26:3A

C. 使用温度範囲 -25 °C ~ +105 °C

(通電による温度上昇も含む)

3. Requirements :

3.1 Design and Construction :

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials :

A. Contact :

Pretin Phosphor Bronze

(0.8 μ m MIN. thick tin-plated)

B. Housing : 66Nylon (UL94V-0)

C. Post Header Assembly Vertical (V),

Post : Pretin-Lead Brass

(0.8 μ m MIN. thick Tin lead plated

over 0.5 μ m MIN. thick copper

underplated)

Housing : 66 Nylon (UL94V-0)

3.3 Ratings :

A. Voltage Rating :250 VAC/DC

B. Current Rating (Maximum)

AWG#22:3A, AWG#24:3A, AWG#26:3A

C. Temperature Rating : -25°C to +105°C

The upper limit of the temperature includes the temperature rising resulted by the energized electrical current.

3.4 適用電線

A. 適用電線サイズ

AWG#22 ~ #26 用 (0.34~0.14mm²)

B. 適用電線被覆外径

φ1.70~φ1.00mm (AWG#22~#26)

3.4 Applicable Wires

A. Applicable Wire Size:

AWG#22 ~ #26 (0.34~0.14mm²)

B. Applicable Insulation Diameter

φ1.70~φ1.00mm (AWG#22~#26)

3.5 適用プリント基板

A. 板厚

1.6mm

B. 穴径

φ0.92~φ1.02mm

3.5 Applicable Printed Circuit Board

A. Board Thickness:

1.6mm

B. Hole Diameter:

φ0.92~φ1.02mm

3.6 性能必要条件と試験方法

製品は Fig. 2 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

3.6 Performance Requirements and Test

Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 2. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

3.7 性能必要条件と試験方法の要約

項目	試験項目	規格値	試験方法
3.7.1	製品の確認	製品図面とAMP取付適用規格 114-5260の必要条件に合致していること。	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する。

3.7 Test Requirements and Procedures Summary:

Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.7.1	Examination of Product	Meets requirements of product drawing and AMP Specification 114-5260.	Visual inspection No physical damage
電 気 的 性 能			
Electrical Requirements			
3.7.2	総合抵抗 (ローレベル)	10 mΩ 以下 (初期) 20 mΩ 以下 (終期)	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧20 mV以下、閉路電流10 mA以下の条件で測定する。 Fig. 4参照。
3.7.2	Termination Resistance (Low Level)	10 mΩ Max. (Initial) 20 mΩ Max. (Final)	Subject mated contacts assembled in housing to 20 mV Max open circuit at 10 mA. Fig. 4.
3.7.3	耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。 リーク電流 5 mA 以下	1k VAC 1分間印加 コネクタ嵌合あり 隣接コンタクト間で測定。 MIL STD 202試験法301
3.7.3	Dielectric withstanding Voltage	No creeping discharge nor flashover shall occur. Current leakage : 5 mA Max.	1k VAC for 1 minute. Test between adjacent circuits of mated connectors. MIL STD 202 TEST METHOD 301
3.7.4	絶縁抵抗	1000 MΩ 以上 (初期) 500 MΩ 以上 (終期)	500 VDC 1分間印加。 コネクタ嵌合あり 隣接コンタクト間で測定。 MIL STD 202試験法302条件A
3.7.4	Insulation Resistance	1000 MΩ Min. (Initial) 500 MΩ Min. (Final)	Impressed voltage 500 V DC. Test between adjacent circuits of mated connectors. MIL STD 202 TEST METHOD 302 CONDITION A

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規 格 値			試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements			Procedures
3. 7. 5	温度上昇	定格電流を通電して、温度上昇は30 °C以下			各極が直列回路になるように接続し、熱電対をコンタクトはんだ付部に取り付け定格電流を通電して試験する。 温度は平衡状態に達したものを熱電対計法によって測定する。測定値より室温を引いたものを温度上昇値とする。 Fig. 4
3. 7. 5	Temperature Rising	30 °C Max. under loaded rating current.			Contacts series-wired, apply test current of loaded rating current to the circuit, and measure the temperature rising by probing on soldered areas of contacts, after the temperature becomes stabilized Deduct ambient temperature from the measured value. Fig. 4
3. 7. 6	圧着部引張強度	電線サイズ		引張強度 (以上)	圧着したコンタクトを試験機に固定し、軸方向引張力を電線に加える。操作速度は50 mm/分 但し、電線被覆部は圧着しない。
		mm ²	(AWG)	N (kgf)	
		0. 30	22	49. 0 (5. 0)	
		0. 20	24	29. 4 (3. 0)	
3. 7. 6	Crimp Tensile Strength	Wire Size		Crimp Tensil (min.)	Apply an axial pull-off load to crimped wire of contact secured on the tester. Operation Speed : 50 mm/min. Samples don't crimp insulation.
		mm ²	(AWG)	N (kgf)	
		0. 30	22	49. 0 (5. 0)	
		0. 20	24	29. 4 (3. 0)	
3. 7. 6	Crimp Tensile Strength	Wire Size		Crimp Tensil (min.)	Apply an axial pull-off load to crimped wire of contact secured on the tester. Operation Speed : 50 mm/min. Samples don't crimp insulation.
		mm ²	(AWG)	N (kgf)	
		0. 30	22	49. 0 (5. 0)	
		0. 20	24	29. 4 (3. 0)	
3. 7. 6	Crimp Tensile Strength	Wire Size		Crimp Tensil (min.)	Apply an axial pull-off load to crimped wire of contact secured on the tester. Operation Speed : 50 mm/min. Samples don't crimp insulation.
		mm ²	(AWG)	N (kgf)	
		0. 30	22	49. 0 (5. 0)	
		0. 20	24	29. 4 (3. 0)	
3. 7. 6	Crimp Tensile Strength	Wire Size		Crimp Tensil (min.)	Apply an axial pull-off load to crimped wire of contact secured on the tester. Operation Speed : 50 mm/min. Samples don't crimp insulation.
		mm ²	(AWG)	N (kgf)	
		0. 30	22	49. 0 (5. 0)	
		0. 20	24	29. 4 (3. 0)	
3. 7. 7	ポスト保持力	22. 54 N (2. 3 kgf) 以上			ポストの保持力を測定 操作速度 : 50 mm/分 Fig. 5
3. 7. 7	Post Retention Force	22. 54 N (2. 3 kgf) Min.			Measure post retention force. Operation Speed : 50 mm/min. Fig. 5

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3. 7. 8	コンタクト保持力	14. 7 N (1. 5 kgf) 以上	コンタクト引抜力を軸方向に加えること。 操作速度 : 50 mm/分
3. 7. 8	Contact Retention Force	14. 7 N (1. 5 kgf) Min.	Apply an axial pull-off load to crimped wire. Operation Speed : 50 mm/min.
3. 7. 9	コンタクト装着力	9. 8 N (1 kgf) 以下 1 コンタクト当り	コンタクトをハウジングに装着するに要する力を測定すること。
3. 7. 9	Contact Insertion Force	9. 8 N (1 kgf) Max. per contact	Measure the force required to insert contact into housing.
3. 7. 10	コネクタ挿抜力	Fig. 6 参照	操作速度 50 mm/分 挿抜に要する力を測定
3. 7. 10	Connector Mating /Unmating Force	See Fig. 6	Operation Speed : 50 mm/min. Measure the force required to mate and unmate connectors.
3. 7. 11	耐久性 (繰り返し挿抜)	20 mΩ 以下 (終期)	挿抜速度 50 mm/min. 挿抜回数 50 回
3. 7. 11	Durability (Repeated Mate / Unmating)	20 mΩ Max. (Final)	Operation Speed : 50 mm/min. No. of Cycles : 50 cycles.

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3. 7. 12	振動 (低周波)	振動中 1 μ sec. を越える不連続導通を生じないこと。 20 m Ω 以下 (終期)	嵌合したコネクタに 1.52 mm の振幅で、10-55-10 Hz に毎分 1 サイクルの割合で変化する掃引振動を直交する三方向軸に 2 時間ずつ与えること。10 mA を通電。 MIL-STD-202試験法213条件A IEC 68-2-6 固定方法 : Fig. 7
3. 7. 12	Vibration (Low Frequency)	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. 20 m Ω Max. (Final)	Subject mated connectors to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.52 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular planes. 10 mA applied. MIL-STD-202 TEST METHOD 213 CONDITION A IEC 68-2-6 Mounting : Fig. 7
3. 7. 13	衝撃	衝撃により1 μ sec. を越える不連続導通を生じないこと。 20 m Ω 以下 (終期)	加速度 : 490 m/s ² (50 G) 衝撃パルス波型 : 半波正弦波 接続時間 : 11 msec. 衝撃回数 : X, Y, Z 軸正負方向に各 3 回宛、合計 18 回 10mA DCを通電 IEC 68-2-27 固定方法 : Fig. 7
3. 7. 13	Physical Shock	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. 20 m Ω Max. (Final)	Accelerated Velocity : 490 m/s ² (50 G) Waveform : halfsine shock pulse Duration : 11 msec. Number of Drops : 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. 10mA DC applied. IEC 68-2-27 Mounting : Fig. 7

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3. 7. 14	微加振動 (ハンマー衝撃)	加振中 1 μ secを越える不連続 導通を生じないこと。 20m Ω 以下 (終期)	嵌合したコネクタをFig. 8に示す条 件で10000回加振し、Fig. 9に示す測 定回路により印加電圧DC 10V, 1mAの 試験電流を通電させた 状態で試験を行い、加振中の抵抗の 変動をモニターする。
3. 7. 14	Hammering Shock	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. 20 m Ω Max. (Final)	Under 10000 cycles of repeated hammering shock of the condition as shown Fig. 8, with the test current of 1mA at 10 VDC applied to the circuit as shown in Fig. 9. During the test, the circuit shall be monitored for fluctuation of electrical resistance.
3. 7. 15	はんだ付け性	90 % 以上濡れていること。	はんだ温度 : 230 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C はんだ浸漬時間 : 3 $\pm$ 0.5 秒 使用フラックス : アルファ 100 (非活性ロジンベース)
3. 7. 15	Solderability	Wet Solder Coverage : 90 % Min.	Solder Temperature : 230 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C Immersion Duration: 3 $\pm$ 0.5seconds Flux : Alpha 100 (NON-active rosin base)

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para	Test Items	Requirements	Requirements
3. 7. 16	はんだ耐熱性	試験後物理的損傷を生じないこと。	<u>フローソルダリングの場合</u> プリント基板に取り付けて試験する。 はんだ温度 260 ± 5℃ はんだ浸せき時間 10 ± 1 秒 <u>手はんだの場合</u> 温度 : 350 ± 10℃、時間 : 3+1, -0, 秒 但し、コンタクトはんだ付部にこて先等による力が加わらないように試験する。
3. 7. 16	Resistance to Soldering Heat	No physical damage shall occur.	<u>Flow Soldering</u> Test connector on PCB. Solder Temperature : 260 ± 5℃ Immersion Duration : 10 ± 1 sec. <u>Manual Soldering</u> Temperature: 350 ± 10 °C for 3+1, -0 Seconds. To be no damage by the top of iron. at soldering tynes.
3. 7. 17	熱衝撃	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを -55 °C / 30 分、+85 °C / 30 分 これを 1 サイクルとし 25 サイクル行う。IEC 68-2-14
3. 7. 17	Thermal Shock	20 mΩ Max. (Final)	Mated connector -55 °C / 30 min., +85 °C / 30 min. Making this a cycle, repeat 25 cycles. IEC 68-2-14

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para	Test Items	Requirements	Requirements
3. 7. 18	耐湿性 (定常状態)	絶縁抵抗 500 MΩ 以上 (終期) 総合抵抗 20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを90~95 %R. H. 40 °C、500時間さらすこと。 IEC 68-2-3
3. 7. 18	Humidity, Steady State	Insulation resistance 500 MΩ Min. (Final) Termination resistance 20 mΩ Max. (Final)	Mated connector, 90~95 % R. H. 40 °C, 500 hours IEC 68-2-3
3. 7. 19	温湿度サイクリング	絶縁抵抗 500 MΩ 以上 (終期) 総合抵抗 20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを 25~65 °C, 90~95 % R. H. 10 サイクル行う。 -10 °C 寒冷衝撃を実施する。 IEC 68-2-38
3. 7. 19	Humidity-Temperature Cycling	Insulation resistance 500 MΩ Min. (Final) Termination resistance 20 mΩ Max. (Final)	Mated connector, 25~65 °C, 90~95 % R. H. 10 cycles Cold shock -10 °C performed IEC 68-2-38
3. 7. 20	塩水噴霧	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを35 ± 2°C 5 ± 1 %の塩水噴霧に48時間さら すこと。試験後塩水を水洗いし、 常温常湿中に1時間放置した後測 定する。 IEC 68-2-11
3. 7. 20	Salt Spray	20 mΩ Max. (Final)	Subject mated 35±2°Cconnectors to 5±1 % salt concentration for 48 hours : Aften test,ninse the samples with waten and recondition the room temperature for hour. IEC 68-2-11
3. 7. 21	温度寿命 (耐熱)	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを 85 ± 2 °C、500 時間さらすこと。 IEC 68-2-2
3. 7. 21	Temperature Life (Heat Aging)	20 mΩ Max. (Final)	Mated connector 85 ± 2 °C, 500 hours IEC 68-2-2

Fig. 2 (To be continued)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para	Test Items	Requirements	Requirements
3.7.22	耐寒性	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを -40 ± 3 °C, 500 時間さらすこと。 IEC 68-2-1
3.7.22	Resistance to Cold	20 mΩ Max. (Final)	Mated connector -40 ± 3 °C, 500 hours IEC 68-2-1
3.7.23	工業ガス (SO ₂)	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを SO ₂ ガス 10 ± 3 ppm, 95 % R. H. 35 ± 2 °C, 240 時間さらすこと。
3.7.23	Industrial Gas (SO ₂)	20 mΩ Max. (Final)	Mated connector SO ₂ Gas : 10 ± 3 ppm, 95 % R. H. 35 ± 2 °C, 240 hours
3.7.24	工業ガス (H ₂ S)	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタを H ₂ S ガス濃度 3 ppm, 40 ± 3°C 75 % R. H. 96時間さらすこと。
3.7.24	Industrial Gas (H ₂ S)	20 mΩ Max. (Final)	Mated connector H ₂ S Gas : 3 ppm, 40±3°C 75% R. H. 96 hours
3.7.25	工業ガス (アンモニア)	20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタをアンモニア水 濃度3 %を1 リットル (デシケータ体積) 当たり25 ccを加えたデシケータ 内に40分放置する。
3.7.25	Industrial Gas (Ammonia)	20 mΩ Max. (Final)	After 40 minute exposure in ammonia chamber with 25 cc of 3 % ammonia solution for every liter of chamber capacity.
3.7.26	耐溶剤性	機能を損なう変形、溶解及び変色のないこと。	嵌合しないコネクタをイソプロピルアルコールに浸漬、 常温、90 秒間
3.7.26	Resistance to Solvent	Connector shall be free from fusion and discoloration that detrimental to connector function.	Unmated connector (Isopropyl alcohol) Immerse in solvent nominal temperature 90 seconds.

Fig. 2 (End)

4. 製品認定試験の試験順序

4. Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Examination	試験グループ/Test Group														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		試験順序/Test Sequence (a)														
製品の確認検査	Examination of Product	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)								2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage	2														
絶縁抵抗	Insulation Resistance	3.5														
温度上昇	Temperature Rising		2													
圧着部引張強度	Crimp Tensile Strength			2												
ポスト保持力	Post Retention Force				2											
コンタクト保持力	Contact Retention Force					2										
コンタクト装着力	Contact Insertion Force						2									
コネクタ挿抜力	Connector Mating/Unmating Force							2								
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)								3							
振動 (低周波)	Vibration (Low Frequency)									3						
衝撃	Physical Shock										3					
微加振動 (ハンマー衝撃)	Hammering Shock											3				
はんだ付け性	Solderability												3			
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat													3		
熱衝撃	Thermal Shock														3	
耐湿性 (定常状態)	Humidity (Steady State)	4														3
温湿度サイクリング	Humidity-Temperature Cycling															
塩水噴霧	Salt Spray															
温度寿命 (耐熱)	Temperature Life (Heat Aging)															
耐寒性	Resistance to Cold															
工業ガス (SO ₂)	Industrial SO ₂ Gas															
工業ガス (H ₂ S)	Industrial H ₂ S Gas															
工業ガス (アンモニア)	Industrial Ammonia Gas															
耐溶剤性	Resistance to Solvent															

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

Fig. 3 (To be continued)

試験項目	Test Examination	試験グループ/Test Group															
		16	17	18	19	20	21	22	23								
		試験順序/Test Sequence (a)															
製品の確認検査	Examination of Product	1, 7	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5	1, 3								
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)	2, 6	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4									
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage																
絶縁抵抗	Insulation Resistance	3, 5															
温度上昇	Temperature Rising																
圧着部引張強度	Crimp Tensile Strength																
ポスト保持力	Post Retention Force																
コンタクト保持力	Contact Retention Force																
コンタクト装着力	Contact Insertion Force																
コネクタ挿抜力	Connector Mating/Unmating Force																
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)																
振動 (低周波)	Vibration (Low Frequency)																
衝撃	Physical Shock																
微加振動 (ハンマー衝撃)	Hammering Shocks																
はんだ付け性	Solderability																
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat																
熱衝撃	Thermal Shock																
耐湿性 (定常状態)	Humidity (Steady State)																
温湿度サイクリング	Humidity-Temperature Cycling	4															
塩水噴霧	Salt Spray		3														
温度寿命 (耐熱)	Temperature Life (Heat Aging)			3													
耐寒性	Resistance to Cold				3												
工業ガス (SO ₂)	Industrial SO ₂ Gas					3											
工業ガス (H ₂ S)	Industrial H ₂ S Gas						3										
工業ガス (アンモニア)	Industrial Ammonia Gas							3									
耐溶剤性	Resistance to Solvent								2								

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

Fig. 3 (End)

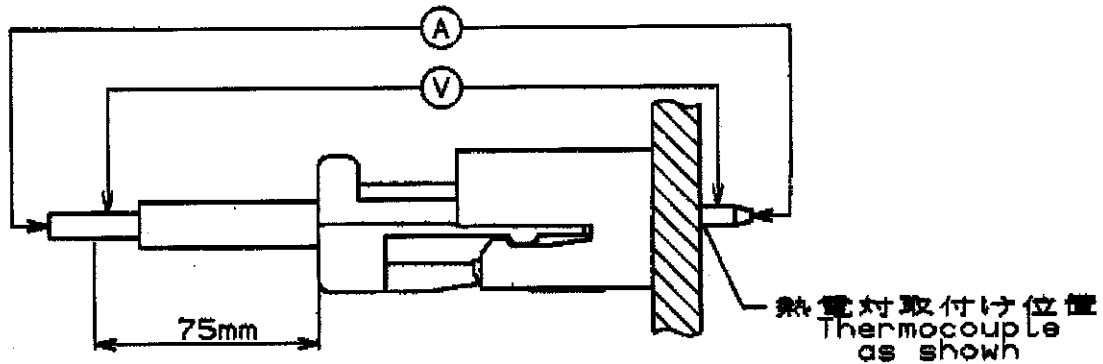


Fig. 4

ポスト保持力
測定方法
POST EXTRACTION FORCE
MEASURING DIRECTION

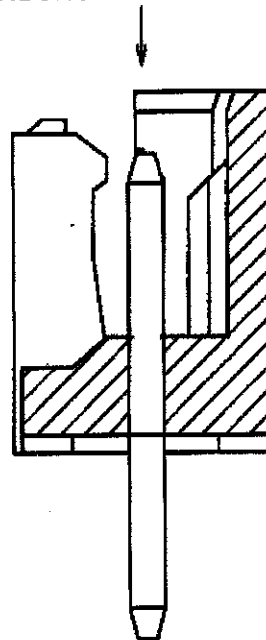


Fig. 5

初回及び50回後 Initial and 50 cycles

No. of Pos 極 数	Connector Mating /Unmating Force コネクタ挿抜力		
	Mating Force N (kgf) max. 初回コネクタ挿入力 N (kgf) 以下	Unmating Force N (kgf). 初回引抜力 N (kgf)	After 50 c/s Unmating Force N (kgf). 50回挿抜後引抜力 N (kgf) 以上
2	19.6 (2.0)	9.8~39.2 (1.0~4.0)	5.9~29.4 (0.6~3.0)
3	24.5 (2.5)	9.8~39.2 (1.0~4.0)	7.8~29.4 (0.8~3.0)
4	29.4 (3.0)	9.8~39.2 (1.0~4.0)	9.8~39.2 (1.0~4.0)
5	34.3 (3.5)	9.8~39.2 (1.0~4.0)	9.8~39.2 (1.0~4.0)
6	39.2 (4.0)	9.8~49.0 (1.0~5.0)	9.8~39.2 (1.0~4.0)
7	44.1 (4.5)	9.8~49.0 (1.0~5.0)	14.7~49.0 (1.0~5.0)
8	49.0 (5.0)	14.7~49.0 (1.5~5.0)	14.7~49.0 (1.5~5.0)
9	53.9 (5.5)	14.7~49.0 (1.5~5.0)	14.7~49.0 (1.5~5.0)
10	53.9 (5.5)	14.7~58.8 (1.5~6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)
11	28.8 (6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)
12	63.7 (6.5)	14.7~58.8 (1.5~6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)
13	63.7 (6.5)	14.7~58.8 (1.5~6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)
14	63.7 (6.5)	14.7~58.8 (1.5~6.0)	14.7~58.8 (1.5~6.0)

Fig. 6

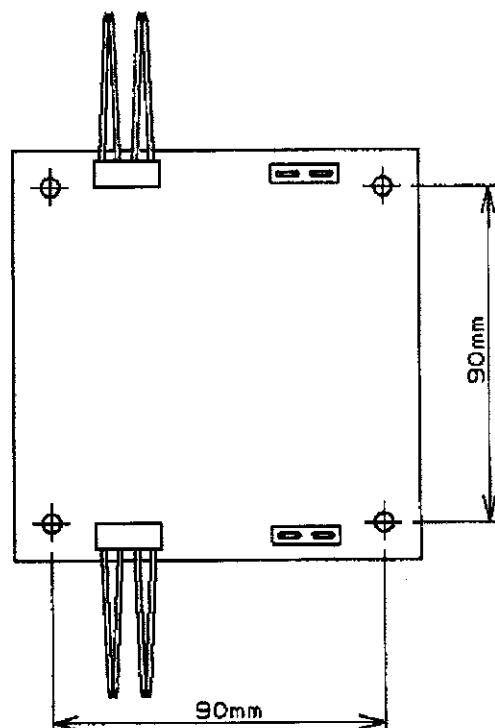


Fig. 7

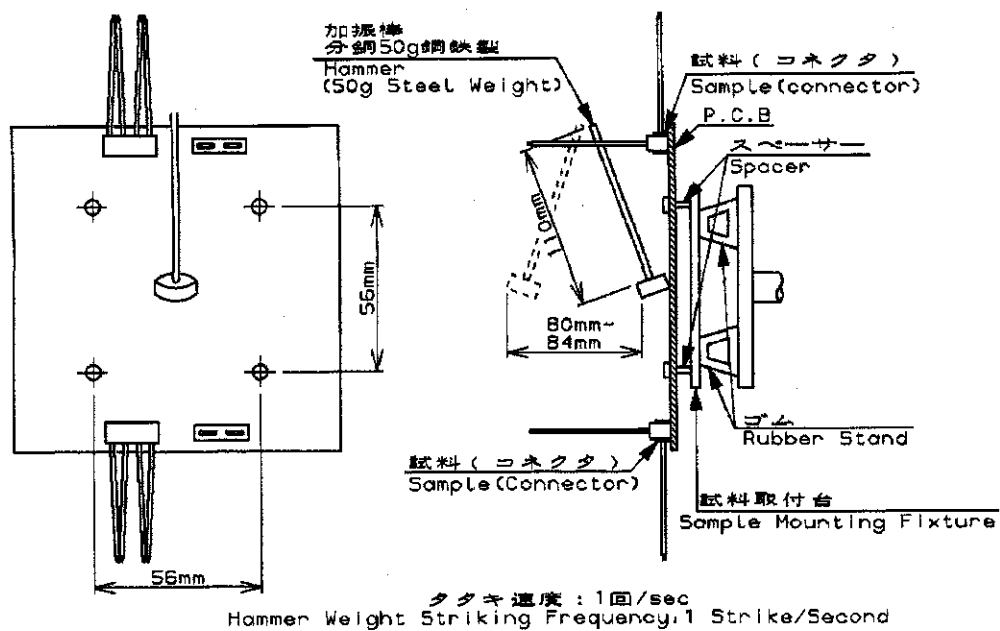


Fig. 8

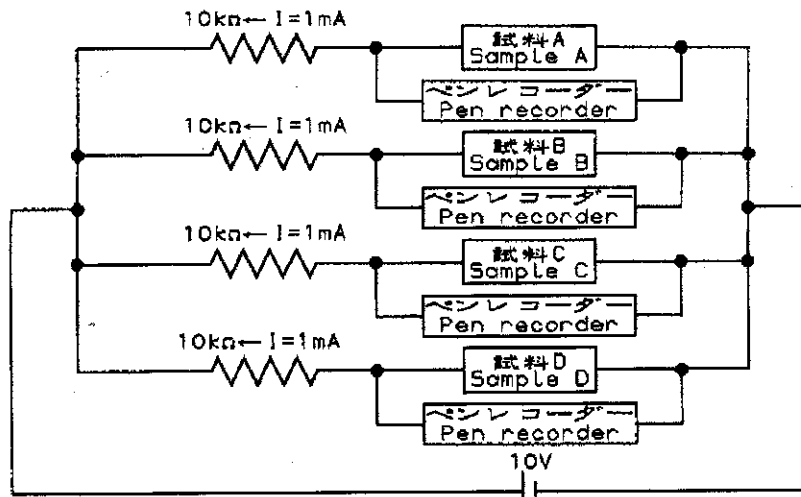


Fig. 9

適用製品名と型番はFig. 1の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Fig. 1.

型番 Product Part No.	品 名	Description
×-92009-×	リセプタクル・ハウジング (圧着型) 極数2~14極	Receptacle Housing (Crimp Type) 2~14 Pos.
×-1123576-×	リセプタクル・コンタクト (クリンプタイプⅢ・連鎖型) AWG#22~#26	Receptacle Contact (Crimp TypeⅢ・Strip Terminal) AWG#22~#26
×-292035-×	ポストヘッダ・アセンブリ (V) 極数2~14極	Post Header Assembly (V) 2~14 Pos.

Fig. 1

5. Validation

作成
(Prepared by)A. Ono
小野 晃仁 A. Ono14/SEP/98
Date検閲
(Checked by)J. Tanigawa
谷川 淳一 J. Tanigawa14/SEP/98
Date承認
(Approved by)S. Kubouchi
久保内 茂 S. Kubouchi14/SEP/98
Date

改訂 LTR	改訂記録 REVISION RECORD	ECN	作成 DR	照査 CHK	承認 APP	DATE
O	RELEASED	FJ00-1641-98	A.O	J.T	S.K	14/SEP/98
A	REVISED	FJ00-2363-98	A.O	J.T	S.K	29/DEC/98
B	REVISED	FJ00-0583-01	K.T	7.7	7.7	24/MAY/01